



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA  
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA  
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA  
UNEFA NÚCLEO PUERTO CABELLO**



**Arquitectura del Computador 3do Corte.**  
**ARQUITECTURAS DE LA ING. DE SISTEMAS.**

Profesor: Ing. Javier Vilchez.

## Grupo 1: El Fin del "Muro de la Memoria" e Interconexiones

Este grupo analiza por qué la memoria RAM tradicional es el actual "cuello de botella".

- **HBM3 vs. DDR5:** Diferencias físicas en el empaquetado y por qué la IA prefiere el ancho de banda sobre la capacidad.
- **Protocolo CXL (Compute Express Link):** Cómo permite que el procesador comparta su espacio de memoria física con aceleradores externos.
- **Tecnología NVLink:** El reemplazo del bus PCIe para la comunicación directa entre tarjetas gráficas.
- **Unified Memory Architecture:** Cómo Apple (Silicon) y NVIDIA están eliminando la separación entre memoria de sistema y memoria de video.
- Ejemplos de su aplicabilidad en la actualidad.

## Grupo 2: Evolución de las ISA (Arquitecturas de Instrucciones)

Investigación sobre cómo el "idioma" que entiende el hardware se adapta a las matemáticas de la IA.

- **Intel AMX (Advanced Matrix Extensions):** Cómo los nuevos procesadores incluyen hardware físico dedicado a multiplicar matrices.
- **RISC-V y Personalización:** Por qué la arquitectura de código abierto es el futuro para crear chips de IA "a medida".
- **Instrucciones SIMD vs. Operaciones de Tensor:** Explicar la diferencia entre procesar vectores y procesar matrices multidimensionales.
- **Compiladores de Hardware (MLIR):** Cómo el software traduce modelos de IA a instrucciones físicas del procesador.
- Ejemplos de su aplicabilidad en la actualidad.

## Grupo 3: Unidades Especializadas (NPU, TPU y Aceleradores)

Diferenciar los nuevos componentes físicos que se han sumado a la arquitectura tradicional.

- **Arquitectura de las NPU (Neural Processing Units):** Cómo funcionan los núcleos de IA en los nuevos procesadores de consumo.
- **Google TPU (Tensor Processing Unit):** El uso de "Arreglos Sistólicos" para procesar datos como un flujo continuo.
- **Eficiencia en TOPS (Tera Operations Per Second):** Cómo medir el rendimiento de un computador de IA más allá de los GHz.
- **Hardware de Precisión Reducida (FP8, INT8):** Por qué la IA no necesita precisión matemática exacta y cómo esto ahorra energía física.
- Ejemplos de su aplicabilidad en la actualidad.

## Grupo 4: Arquitectura Distribuida y Centros de Datos

Cómo se escalan las bases de datos y la arquitectura lógica para la inteligencia masiva.

- **Clústeres de GPU:** El diseño físico de un "Supercomputador de IA".
- **Hardware para Bases de Datos Vectoriales:** Cómo se optimiza el almacenamiento para buscar información por similitud y no por tablas tradicionales.
- **InfiniBand vs. Ethernet:** Por qué las redes de servidores de IA necesitan cables y protocolos especiales para evitar latencia.
- **Sistemas de Enfriamiento Líquido:** El reto físico de mantener operativas las arquitecturas de alto rendimiento.
- Ejemplos de su aplicabilidad en la actualidad.

## Grupo 5: Edge AI y Arquitecturas de Bajo Consumo

La IA llevada a la parte física de los dispositivos móviles y sensores.

- **Arquitectura ARM en el Escritorio:** Cómo los procesadores de bajo consumo están desplazando a la arquitectura x86.
- **In-Memory Computing:** El concepto de procesar datos directamente donde se almacenan (en la RAM/ROM) para evitar el calor.
- **Cuantización en Hardware:** Cómo "comprimir" un modelo de IA para que quepa en la memoria limitada de un microcontrolador.
- **Seguridad a Nivel de Chip:** Cómo la arquitectura protege los datos del usuario cuando la IA se ejecuta localmente.
- Ejemplos de su aplicabilidad en la actualidad.

**NOTA:**

**La evaluación será tipo defensa grupal, mas diapositiva a los temas correspondientes por grupo.**

**Presencia.**

**Léxico.**

**Dominio del tema.**

**Uso del Material de apoyo.**